

Test elettrico: superato del 100%

Spessore scheda finale: 1,8 +/- 0,15 mm

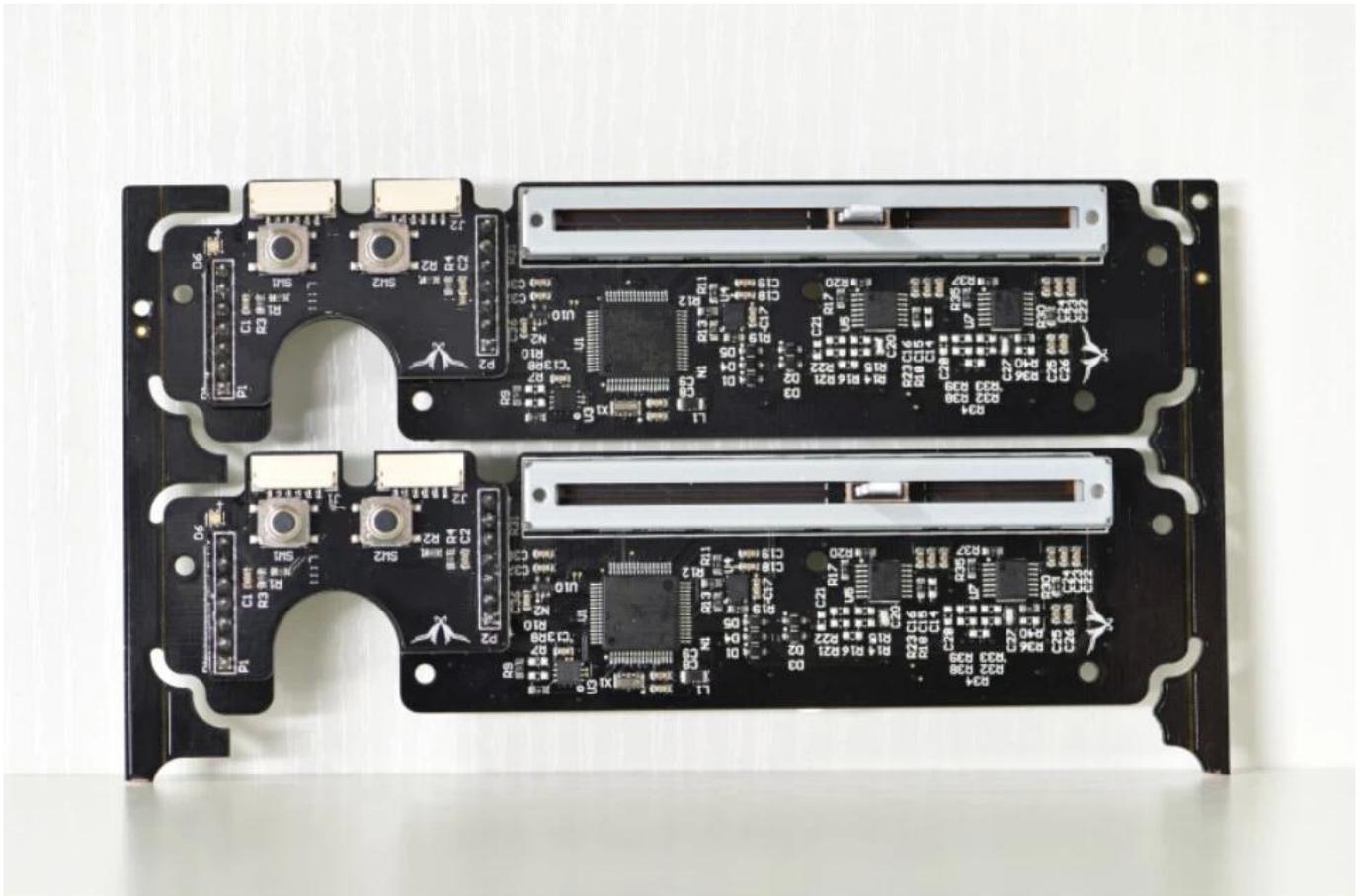
FINITURA: QUESTA SCHEDA DEVE ESSERE IMMERSION GOLD PLATED SECONDO IPC-6012. LO SPESSORE DEVE ESSERE 0,50 M OLTRE 3-6uM NICHEL.

PIASTRA DI RAME HOLES MIN .025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE COLLEGATI,

Imballaggio & Consegna

Dettagli sul confezionamento:	Confezionato sottovuoto
Dettaglio di consegna:	7-10days





fabbrica: [Porcellana](#) [Fabbricazione del bordo del PWB del telefono cellulare, porcellana libera del fornitore del PWB di Holgen](#)